

混合記憶體立方聯盟發佈新規範 推動混合記憶體立方的性能和行業應用

加州聖約瑟和愛達荷州博伊西，2014 年 11 月 19 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 混合記憶體立方聯盟 (HMCC) 一直致力於開發和建立混合記憶體立方 (HMC) 的行業標準介面規範，今日宣佈其 HMCC 2.0 規範 (HMCC 2.0) 已定稿並公開。

新的 HMCC 2.0 規範將資料傳輸率從 15 Gb/秒提高到 30 Gb/秒，為記憶體性能建立了新的門檻。HMCC 2.0 還將相關通道模型從短距離 (SR) 遷移到非常短距離 (VSR)，以便與現有行業命名法保持一致。

“自成立以來，混合記憶體立方聯盟已擁有 150 位成員，發展勢頭迅猛，因此，在如何使介面更好地符合將來的應用上獲得了越來越多更好的意見，” Objective Analysis 主管 Jim Handy 說。“發佈 HMCC 2.0 規範表明了對發展一系列針對所有高性能計算應用的規範的承諾。”

HMCC 成立於 2011 年 10 月，由 Altera、Micron、Open-Silicon、Samsung Electronics 和 Xilinx 合作開發。2013 年 5 月，HMCC 初次定稿並發佈，表明半導體開發的領導者們達成共識，以推動 HMC 在下一代系統中的應用。自成立以來，HMCC 已逐漸吸納了 150 多家 OEM、推動者和集成商，成員們定期參與 HMC 標準的開發和討論。第二代 HMCC 規範的定稿是該創新記憶體技術開發過程中的一個重要里程碑並預示其後續應用。

“HMCC 2.0 為設計師提供了成熟的解決方案，以突破記憶體瓶頸並提供具有空前記憶體性能的新一代系統，” Open-Silicon 的 IP 和工程運營副總裁 Hans Boumeester 說。“新標準得到批准意味著設計師將能獲得符合標準的 IP，可立刻集成到滿足下一代資料中心和高性能計算應用不斷增長的頻寬需求的晶片和系統中。”

關於 HMC

HMC 已被行業領導者和有影響力的人士視為一項萬眾期待的技術方案，它突破了傳統記憶體技術所受限制，在提供超高系統性能的同時顯著減少了每比特耗電量。當代 HMC 技術提供的頻寬是 DDR3 模組的 15 倍，而耗電量比該技術降低 70% 以上，體積減小 90% 以上。HMC 的抽象記憶體使設計師可將更多時間投入如何利用 HMC 的革命性功能和性能上，減少為實現基本功能而選擇多個記憶體參數所需時間。它還能管理糾錯、恢復、刷新和因記憶體過程變化而惡化的其他參數。

關於 HMCC

混合記憶體立方聯盟由全球半導體界的領導成員建立，致力於開發和建立混合記憶體立方技術的行業標準介面規範。聯盟成員包括 Altera Corporation、ARM、IBM、Micron Technology, Inc.、Open-Silicon, Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、SK hynix Inc. 和 Xilinx, Inc.。欲知有關 HMCC 的更多資訊，請訪問：www.hybridmemorycube.org。

聯繫方式：Karl Stetson
Zeno Group for Micron
Karl.stetson@zenogroup.com
206-297-5943